

【第2回】車載半導体の安定調達に向けた取り組みに関する説明会 ～車載半導体データプラットフォーム～

モビリティ産業 7つの課題の 1 つである「半導体の国際競争力確保」に向け、これまで日本自動車工業会（JAMA）と日本自動車部品工業会（JAPIA）は両会に WG（ワーキンググループ）を設置し、まずは車載半導体の安定調達に資する取り組みを連携して進めて参りました。

この度、前回の新陳代謝促進ガイドラインを中心とした説明会に続き、半導体の安定調達に必要なデータを一括管理することで、半導体の生産終了に備えた準備や災害など有事における円滑な BCP 対応に繋げることを目的とした業界共通のデータプラットフォームの構築に関し、大枠が固まりましたので、第 2 回の説明会を開催いたしますので、下記の通りご案内をさせていただきます。

日 時：令和 8 年 1 月 14 日（水） 13:00～14:00（1 時間）

場 所：オンライン開催

※Zoom でのオンライン開催 ※視聴 URL は申込者へ別途送付いたします。

主 催：一般社団法人日本自動車工業会（JAMA）、一般社団法人日本自動車部品工業会（JAPIA）

※以下、自工会、部工会にて省略

次 第：

	議題	説明者	時間
1	自工会「7つの課題」と取り組みの背景	自工会 半導体 WG	5 分
2	車載半導体データプラットフォーム	自工会 半導体 WG	30 分
3	依頼事項	自工会/部工会 半導体 WG	5 分
4	質疑応答	自工会/部工会 半導体 WG	20 分
計			60 分

※次第内容、説明者は変更になる場合がございます。

【申込要領】

参 加 企 業：自工会 会員企業と車載半導体を取り扱っている部工会 会員企業およびそのグループ会社
※グループ会社様につきましては、会員企業様より本案内の展開をお願いいたします。

参加対象者：車載半導体またはそれを搭載する部品の購買・調達を担当している部門の管理者または担当者

定 員：回線上限数 500（Zoom ウェビナー）

※定員に達した場合は回線数を調整(減らして)いただく場合もございます。予め御了承ください。

入 場 料：無料

申込方 法：参加希望の方は以下のサイトにアクセスし、お申し込みください。

※1回線で複数名が視聴される場合は1度の申し込みで結構です。

https://www.japia.or.jp/0827handotai_session/

申込締切日：令和 8 年 1 月 7 日（水）

そ の 他：当日の説明会動画を後日ホームページ上にアーカイブ配信を予定しております。

問 合 せ 先：一般社団法人 日本自動車部品工業会 業務部 伊藤、田中

電話 03-3445-4214 ito-sota@japia.or.jp

以上